

FUJITSU FUJITSU PLM 解决方案

良品解析事例 (Ag线IC开封)



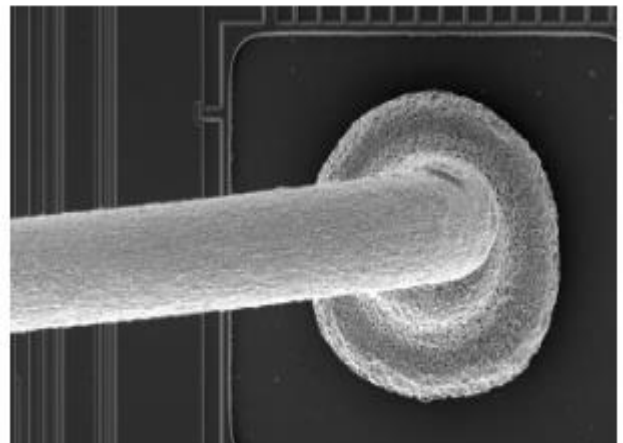
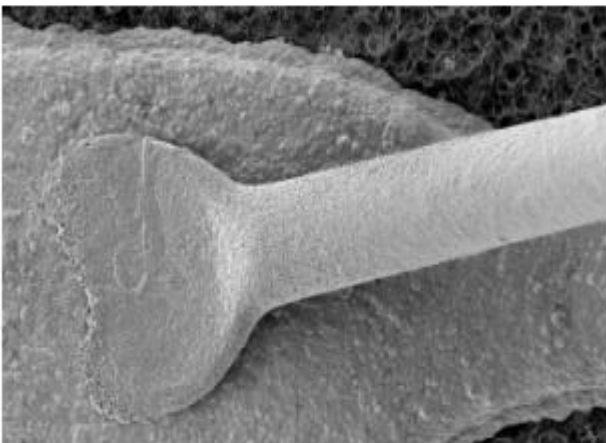
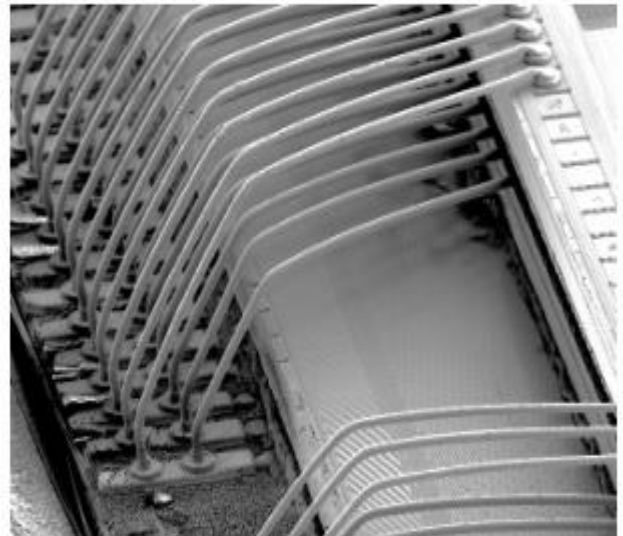
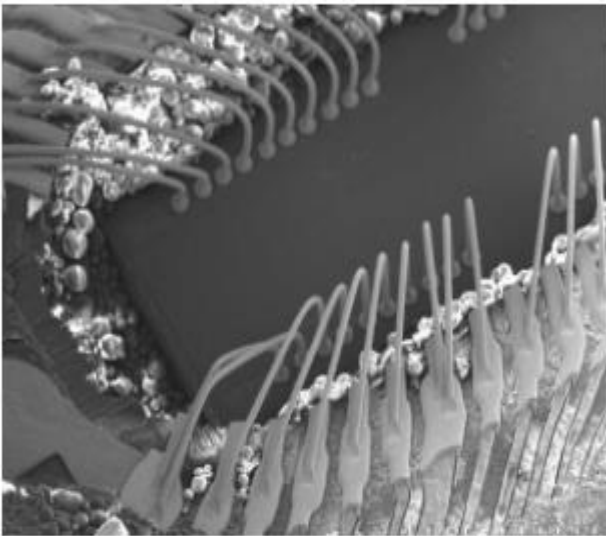
概要

Ag线IC的树脂去除的难点在于使用药品对Ag线的损伤较大。我司根据饱和法原理开发了可以避免损伤的开封方法，以此可进行绑定状态下的观察。详细介绍如下。

特征

结合线表面的观察、连接状况的确认、放射观察的通电等目的，实施封装开封。
(由于开封后线的状态因树脂类型、线种类、形状等程度各异，故建议提前试做。)

去除树脂后线的状态



※) 采用サイエンティフィック株式会社の饱和法